

**金元证券股份有限公司关于
佛山市蓝箭电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市保荐书**

保荐机构（主承销商）



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

（海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼）

二〇二三年七月

声 明

金元证券股份有限公司及本项目保荐代表人张敏、卢丹琴已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义）

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 发行人基本情况	3
一、发行人简介.....	3
二、发行人主营业务经营情况.....	3
三、发行人核心技术.....	6
四、发行人研发水平.....	6
五、主要经营和财务数据及指标.....	9
六、发行人面临的主要风险.....	10
第二节 申请上市股票的发行情况	15
一、本次发行概况.....	15
二、本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	15
三、保荐人与发行人关联关系的说明.....	18
第三节 保荐机构承诺	19
第四节 对本次证券发行上市的保荐结论	20
一、本次发行上市履行了法定的决策程序.....	20
二、符合板块定位及国家产业政策的说明.....	20
三、符合创业板上市条件的说明.....	26
四、对发行人持续督导期间的工作安排.....	30
五、保荐结论.....	31

第一节 发行人基本情况

一、发行人简介

中文名称	佛山市蓝箭电子股份有限公司
英文名称	Foshan Blue Rocket Electronics Co., Ltd.
注册资本	15,000 万元人民币
法定代表人	王成名
有限公司成立日期	1998 年 12 月 30 日
股份公司成立日期	2012 年 6 月 29 日
住所	佛山市禅城区古新路 45 号
经营场所	广东省佛山市禅城区古新路 45 号
经营范围	设计、制造、销售：半导体及相关产品、LED 及应用产品、光伏产品，其他电子电气产品，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
邮政编码	528051
电话号码	0757-63313388
传真号码	0757-63313400
互联网网址	http://www.fsbrec.com
电子信箱	lanjian@fsbrec.com
负责信息披露和投资者关系的部门	证券部
信息披露负责人	张国光
信息披露负责人电话	0757-63313388-8116

二、发行人主营业务经营情况

（一）发行人主要业务概述

公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。

公司注重封装测试技术的研发升级，通过工艺改进和技术升级构筑市场竞争优势，掌握金属基板封装、全集成锂电保护 IC、功率器件封装、超薄芯片封装、半导体/IC 测试、高可靠焊接、高密度框架封装、系统级封装（SIP）等一系列核心技术，在封装测试领域具有较强的竞争优势。

公司持续加大对半导体封测技术的研发及创新投入，建立了半导体器件工程

技术研究开发中心，并获得了广东省省级企业技术中心认定。公司拥有国内外先进的检测、分析、试验设备，利用统计过程控制（SPC）等工具实现严格的过程控制，拥有较为完善的设备试生产、验收流程，推行全员生产维护（TPM）管理模式和专业、专职的产品经理团队。

公司荣获高新技术企业、国家知识产权优势企业等资质及荣誉。公司多次荣获广东省科学技术奖、佛山市科学技术奖等省、市科技奖项。

目前，公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、IATF16949 汽车行业质量管理体系标准认证、知识产权管理体系认证及职业健康管理体系认证等多项行业标准认证。

（二）主要产品及其用途

公司主要封测产品为分立器件和集成电路产品。公司分立器件产品涉及 30 多个封装系列，3,000 多个规格型号，产品包括功率三极管、功率 MOS 等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品；集成电路产品包括锂电保护 IC、AC-DC、DC-DC、驱动 IC 等功率 IC 产品。目前公司已形成年产超 150 亿只半导体产品的生产规模。

公司主要产品广泛应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域。

（三）所需主要原材料及重要供应商

公司封装测试主要原材料包括晶圆、框架、塑封料、内引线等。报告期内，公司主要合作的原材料厂商包括台湾友顺、康强电子、宁波港波电子有限公司、扬州晶新微电子有限公司等国内外知名厂商。

（四）主要生产模式

针对半导体行业生产特点和需求特征，公司采用销售预测和订单结合的方式安排生产计划。公司自有品牌模式下，主要采取备货式生产；封测服务模式下主要采取订单式生产。

公司主要采用自主生产的模式开展生产经营活动。对于公司核心产品的需求和大批量的封测订单由公司自主完成；对于客户少量配套产品及小量需求，为提

升市场需求的响应速度，公司采用外协生产模式。

（五）销售方式和渠道及重要客户

公司采取直销的销售模式，即直接面对客户进行销售。公司客户分为非贸易商客户和贸易商客户。公司存在贸易商客户系由半导体产业链特征决定的，半导体器件广泛应用于消费类市场，下游客户众多且较为分散，贸易商凭借其独立的市场渠道，可以覆盖更多的客户，增加公司产品覆盖区域。公司的贸易商客户不属于经销商，公司的贸易商客户具有完全独立的市场渠道、客户和存货管理体系，公司不对其进行管理和考核，不存在销售返利政策。公司与贸易商客户签订采购合同仅与产品购销相关，无排他性的独家经营和销售公司产品的条款，不涉及公司自有品牌、指定销售区域及客户开发等约定，贸易商客户对公司产品的付款不以其销售给最终客户为前提。

公司自成立以来坚持以技术创新为核心，凭借多年丰富的行业经验积累以及自主研发能力，秉承“以客户需求为中心”的服务理念，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，公司客户遍布华南、华东、西北、西南等多个区域，产品广泛应用于家用电器、信息通信、电源、电声等诸多领域。公司服务的客户包括：拓尔微、华润微、晶丰明源等半导体行业客户；美的集团、格力电器等家用电器领域客户；三星电子、普联技术等信息通信领域客户；赛尔康、航嘉等电源领域客户；漫步者、奥迪诗等电声领域客户。多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。

（六）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

目前，我国半导体封装测试行业整体处于充分竞争的状态。在半导体全球产业链第三次转移的过程中，我国半导体封装测试技术整体与国际水平相接近。

公司目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合，已形成年产超 150 亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业。

三、发行人核心技术

公司自成立以来，一直专注于半导体封装测试业务，拥有较为完善的封装测试技术，核心技术均来源于自主研发，目前在金属基板封装、全集成的锂电保护 IC 等多方面拥有核心技术。公司主要核心技术包括：

核心技术	专利	所处阶段	技术来源
金属基板封装技术	<p>本项核心技术涉及 4 项专利，其中 1 项发明专利，实用新型专利 3 项：</p> <p>1、一种晶圆自动剥料设备的输送上料装置及输送上料方法，专利号：ZL202210985370.X（发明专利）</p> <p>2、一种粘片设备的挤胶装置连接器，专利号：ZL201721383414.2（实用新型）</p> <p>3、一种晶体管封装检测用托盘，专利号：ZL201821700105.8（实用新型）</p> <p>4、扩片装置及固晶机，专利号：ZL201821774349.0（实用新型）</p>	批量生产	原始取得
功率器件封装技术	<p>本项核心技术涉及 9 项专利，其中发明专利 7 项，实用新型 2 项：</p> <p>1、一种塑封模具结构，专利号：ZL201410658319.3（发明专利）</p> <p>2、一种 IGBT 器件的复合装载连线方法，专利号：ZL201210572126.7（发明专利）</p> <p>3、一种肖特基二极管的工艺设计，专利号：ZL201610963476.4（发明专利）</p> <p>4、一种快速脱模的塑封模具，专利号：ZL201910880353.8（发明专利）</p> <p>5、一种半导体封装器件以及制造方法，专利号：ZL202211264676.2（发明专利）</p> <p>6、一种半导体生产用线材的导向器，专利号：ZL202210954285.7（发明专利）</p> <p>7、一种晶圆自动剥料设备的输送上料装置及输送上料方法，专利号：ZL202210985370.X（发明专利）</p> <p>8、一种凸点式封装搭桥功率器件，专利号：ZL202020823558.0（实用新型）</p> <p>9、一种功率器件框架分离装置，专利号：ZL201721037516.9（实用新型）</p>	批量生产	原始取得
半导体 IC 测试技术	<p>本项核心技术涉及 5 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型 3 项：</p> <p>1、半导体三极管发生 BVCEO 软击穿的测试方法，专利号：ZL200810184515.6（发明专利）</p> <p>2、三极管在反向偏压安全工作区下的测试装置及测试方法，专利号：ZL201010219663.4（发明专利）</p> <p>3、半导体器件高温性能的测试和分选装置，专利号：ZL201320390760.9（实用新型）</p> <p>4、一种半导体元器件绝缘测试装置。专利号：ZL201620538298.6（实用新型）</p> <p>5、一种半导体元器件的多工位测试装置，专利号：</p>	批量生产	原始取得

核心技术	专利	所处阶段	技术来源
	ZL201620552944.4 (实用新型)		
超薄芯片封装技术	<p>本项核心技术涉及 6 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型 4 项：</p> <p>1、一种自动粘片机三维运动焊头的控制系统和控制方法，专利号：ZL201410038858.7 (发明专利)</p> <p>2、一种晶圆自动剥料设备的输送上料装置及输送上料方法，专利号：ZL202210985370.X (发明专利)</p> <p>3、一种全自动固晶机的温度偏差报警装置，专利号：ZL201520590046.3 (实用新型)</p> <p>4、一种粘片设备的挤胶装置连接器，专利号：ZL201721383414.2 (实用新型)</p> <p>5、一种可拆卸替换的点胶粘片机点胶头，专利号：ZL201821130667.3 (实用新型)</p> <p>6、扩片装置及固晶机，专利号：ZL201821774349.0 (实用新型)</p>	批量生产	原始取得
高可靠焊接技术	<p>本项核心技术涉及 5 项专利，其中 1 项发明专利，实用新型 4 项：</p> <p>1、一种晶圆自动剥料设备的输送上料装置及输送上料方法，专利号：ZL202210985370.X (发明专利)</p> <p>2、用于半导体封装焊线设备的防氧化装置，专利号：ZL201620498372.6 (实用新型)</p> <p>3、一种规格可调式焊压夹具，专利号：ZL201320764196.2 (实用新型)</p> <p>4、一种用于压紧引线框架的装置，专利号：ZL201621105900.3 (实用新型)</p> <p>5、一种用于半导体焊线设备放线装置的滚轮调节装置，专利号：ZL201720683753.6 (实用新型)</p>	批量生产	原始取得
高密度框架封装技术	<p>本项核心技术涉及 2 项发明专利：</p> <p>1、SOT23-X 引线框架及其封装方法，专利号：ZL201811317871.0 (发明专利)</p> <p>2、硅芯片封装引线框架及其封装方法，专利号：ZL201811359648.2 (发明专利)</p>	批量生产	原始取得
应用于半导体封装的机器人自动化生产系统	<p>本项核心技术涉及 4 项专利，其中发明专利 1 项，实用新型 3 项：</p> <p>1、全自动分片装置，专利号：ZL201410407227.8 (发明专利)</p> <p>2、全自动排片机，专利号：ZL201520880923.0 (实用新型)</p> <p>3、一种半导体封装模具脱模装置，专利号：ZL201220473732.9 (实用新型)</p> <p>4、一种塑封机的自动上料装置，专利号：ZL201520495432.4 (实用新型)</p>	批量生产	原始取得
全集成锂电保护 IC 技术	<p>本项核心技术涉及 2 项集成电路布图设计专有权：布图设计名称 A0166 (登记证号：BS.195018869)；布图设计名称 A0161 (登记证号：BS.195018850)</p>	批量生产	原始取得
SIP 系统级封装技术	<p>本项核心技术涉及 5 项专利，其中发明专利 2 项，实用新型 3 项：</p> <p>1、一种自动粘片机三维运动焊头的控制系统和控制方</p>	批量生产	原始取得

核心技术	专利	所处阶段	技术来源
	法，专利号： ZL201410038858.7（发明专利） 2、一种晶圆自动剥料设备的输送上料装置及输送上料方法 ZL202210985370.X 3、一种粘片设备的挤胶装置连接器，专利号： ZL201721383414.2（实用新型） 4、用于生产 SOP 封装双晶体管的连体机及其连接支架，专利号： ZL201920963624.1（实用新型） 5、一种可拆卸替换的点胶粘片机点胶头，专利号： ZL201821130667.3（实用新型）		

四、发行人研发水平

（一）荣誉奖项及科研成果

近年来，公司紧紧围绕半导体封装测试主业，加大研发投入，取得了一系列成果，获得多项国家、省、市荣誉，公司主要获得荣誉情况如下：

序号	颁发时间	荣誉名称	颁发单位
1	2022 年	国家知识产权优势企业	国家知识产权局
2	2022 年	质量管理示范企业	佛山市质量管理协会
3	2021 年	高质量发展创优单位	佛山市质量管理协会
4	2021 年	佛山高新区企业创新积分百强企业	佛山高新技术产业开发区管理委员会
5	2020 年	领军企业	佛山高新技术产业开发区管理委员会
6	2020 年	高新技术企业	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局
7	2020 年	广东省民营企业创新产业化示范基地	广东省工业和信息化厅
8	2019 年	国家知识产权优势企业	国家知识产权局
9	2018 年	广东省电子信息行业创新企业	广东省电子协会
10	2016 年	广东省机械工程学会科学技术奖励（二等奖）	广东省机械工程学会
11	2016 年	广东省机械工业科学技术奖励（二等奖）	广东省机械工程学会、广东省机械行业协会
12	2014 年	广东省科学技术奖（三等奖）	广东省人民政府

公司主持承担多项科研项目，重要科研成果如下：

年份	项目名称	承担单位	参与单位	项目类别	目前进度
2022 年	GaN 功率器件 DFN8 ×8_3L 封装工艺开	蓝箭电子	-	企业自立	小试

年份	项目名称	承担单位	参与单位	项目类别	目前进度
	发				
2021年	基于可穿戴电子产品的DFN封装前沿技术应用场景示范项目	蓝箭电子	-	2021年佛山高新区前沿技术应用场景试点示范项目	已完成
2020年	基于铝带&写锡工艺的矩阵式引线架封装技术	蓝箭电子	-	企业自立	已完成
2020年	基于Clip bond工艺的封装结构	蓝箭电子	-	企业自立	已完成
2020年	基于金属基板封装工艺的DFN封装结构	蓝箭电子	-	企业自立	已完成
2017年	基于大尺寸硅衬底的GaN高速功率开关器件关键技术研究	中山大学	蓝箭电子等	广东省重大科技专项	已完成
2015年	智能家居终端电源的功率器件研发与产业化	蓝箭电子	中山大学	2015年广东省应用型科技研发专项资金项目	已完成
2012年	基于家电与工控领域的新型功率器件研发与产业化	蓝箭电子	中国科学院微电子研究所	2012年广东省中国科学院全面战略合作项目	已完成
2012年	半导体元器件及其检测设备开发——VDMOS和IGBT及其检测设备开发	蓝箭电子	-	广东省战略新兴产业发展专项资金（高端新型电子信息）项目	已完成

（二）公司研发投入情况

报告期内公司研发投入情况如下表：

项目	2022年	2021年	2020年
研发投入（万元）	3,970.02	3,606.81	2,774.99
营业收入（万元）	75,163.36	73,587.41	57,136.49
占营业收入比重（%）	5.28	4.90	4.86

五、主要经营和财务数据及指标

根据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，报告期内发行人主要财务数据及财务指标如下：

项目	2022.12.31/ 2022年	2021.12.31/ 2021年	2020.12.31/ 2020年
资产总额（万元）	112,123.77	113,280.18	96,316.46
归属于母公司所有者权益（万	72,521.63	65,379.17	63,652.11

项目	2022.12.31/ 2022 年	2021.12.31/ 2021 年	2020.12.31/ 2020 年
元)			
资产负债率（母公司）（%）	35.32	42.29	33.91
营业收入（万元）	75,163.36	73,587.41	57,136.49
净利润（万元）	7,142.46	7,727.06	18,435.29
归属于母公司所有者的净利润（万元）	7,142.46	7,727.06	18,435.29
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,540.05	7,209.04	4,324.51
基本每股收益（元）	0.48	0.52	1.23
稀释每股收益（元）	0.48	0.52	1.23
加权平均净资产收益率（%）	9.85	11.70	33.87
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,599.53	4,763.78	5,098.44
现金分红（万元）	-	6,000.00	-
研发投入占营业收入的比例（%）	5.28	4.90	4.86

六、发行人面临的主要风险

（一）发行人在技术水平、产品结构、收入规模等方面与行业龙头厂商存在较大差距，且部分产品替代性较高的风险

从技术水平的角度对比，公司目前以传统封装技术为主，主要封装系列包括 SOT、TO、SOP 等，该系列以传统封测技术为主；在先进封装领域，公司目前掌握的先进封装技术较少，而同行业长电科技、华天科技、通富微电等龙头封测厂商在先进封装领域拥有 FC、BGA、WLCSP、SIP 等多项先进封装技术。龙头厂商在先进封装技术领域保持了行业领先的竞争优势，公司与龙头厂商在先进封装领域的技术水平存在较大差距。

从产品结构的角度对比，公司自有品牌产品主要集中于分立器件的三极管、二极管和场效应管三大类产品；集成电路封测服务主要为电源管理产品，以模拟电路产品为主，逐步涉足数字电路产品领域；同时龙头封测厂商如长电科技、华天科技、通富微电等拥有的产品类型覆盖数字电路、模拟电路等多个领域，除传统封装系列外，还涉足 BGA、SIP、WLCSP 等多个先进封装系列。对比同行业可比公司的产品类型及结构，公司产品结构较为单一，对下游市场变化和行业变化引起的风险抵抗能力较弱。

从业务规模的角度对比，公司业务规模、资本实力等方面与行业内龙头企业相比差距较大，公司收入和净利润规模较小，若未来发行人产品市场发生变化或者毛利率下滑较大，将会对发行人的盈利能力带来重大不利影响。

综上，公司与同行业龙头企业对比，在技术水平、产品结构、收入规模等方面存在较大差距，一方面公司若不能保持传统封装的工艺技术优势，未能在先进封装技术领域有所突破，未能在产品类型和结构上继续丰富，将面临市场竞争力不足的风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响；另一方面，公司目前自有品牌产品以三极管、二极管和场效应管为主，部分产品标准化及通用性程度较高，与同行业上市公司相比，产品竞争力较弱。若公司不能通过技术升级将新材料、新技术应用于上述通用产品，实现产品升级，相关产品将面临被替代的风险。

（二）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 57,136.49 万元、73,587.41 万元和 75,163.36 万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为 4,324.51 万元、7,209.04 万元和 6,540.05 万元。2022 年初以来，部分下游市场领域需求不足，对公司经营业绩产生一定不利影响，公司存在经营业绩波动风险。

随着上游晶圆制造领域技术不断革新、下游消费市场对于低功耗、小型化器件需求不断增长，市场对半导体封测厂商的技术能力、管理水平、创新持续性等要求不断提升，若公司不能及时提供满足市场需求的封测服务和产品，将导致公司未来经营业绩存在下降的风险。

（三）半导体行业周期波动的风险

公司主要从事半导体封装测试，半导体行业与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。半导体封测行业受下游半导体市场及终端消费需求波动的影响，其经营业绩也往往呈现一定的周期性。据新材料在线数据显示，预计 2021-2025 年中国半导体封测市场规模从 2,900 亿元增长至 4,900 亿元，年复合增长率达 14.01%。受全球半导体供应链失衡影响，2020 年以来国内半导体封测市场景气度不断提升，2021 年行业景气度维持高位运行，2022 年半导体封装测试行业市场景气度有所波动。如果未来半导体行业景气度下滑，导致半导体封测市场需求减少，将给公司的业绩带来不利影响。

（四）毛利率波动风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 19.97%、23.11%和 19.63%，公司主营业务毛利率存在一定的波动。其中，报告期内公司自有品牌产品毛利率分别为 14.49%、23.82%和 19.94%，公司自有品牌产品毛利率存在一定的波动；报告期内公司封测服务产品毛利率分别为 25.68%、22.43%和 19.35%，公司封测服务产品毛利率逐年下降。

公司主营业务毛利率主要取决于产品结构、市场竞争及商务谈判情况等因素。公司产品的品种繁多，不同产品的性能、用途以及成本、价格存在一定程度的差异。未来若上述因素发生不利变动，如果公司不能采取有效措施应对不利因素的影响，将导致公司主营业务毛利率出现波动或持续下降的风险。以 2022 年经营业绩为例，假设其他因素不变，若公司自有品牌产品毛利率下降 1%、2%、3%，则主营业务毛利率将分别下降 0.80%、1.25%、1.71%；若公司封测服务产品毛利率下降 1%、2%、3%，则主营业务毛利率将分别下降 0.89%、1.44%、1.98%，由此将对公司的经营业绩带来不利影响。

（五）先进封装收入占比较少，技术研发压力较大的风险

目前半导体封测行业正在经历从传统封装向先进封装的转型。封测技术需要紧跟市场需求，芯片设计、晶圆制造等领域的技术进步及下游对于小型化、低功耗器件持续增长的需求，对封测技术研发不断提出新要求。

报告期内，公司主要收入来源于传统封装产品，先进封装系列主要包括 DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主营业务收入的比重分别为 9.08%、14.34%和 19.49%，占比较少。公司虽然在封装技术、封装工艺上拥有一定研发经验，先进封装收入增长及占比提升明显，但在先进封装技术研发方向上仍需储备大量人才，有待进一步拓展先进封装技术覆盖范围。

若公司未来的技术研发方向不能顺应市场先进封装技术的变化及不断提高的工艺标准，公司将面临无法持续满足下游领域对于产品技术升级的需求，技术研发压力较大，研发投入无法取得预期效果，对公司未来经营业绩将造成不利影响。

（六）产品销售价格波动的风险

半导体产品价格受技术发展、行业竞争状况、行业周期性以及下游需求变动等多种因素影响。短期来看，市场需求和供应将成为产品价格波动的主要因素，当市场需求快速增长，但供给不足时，产品售价将波动上升；随着行业产能持续释放，市场需求逐步放缓，产品销售价格将出现波动下降的趋势。长期来看，技术发展和行业竞争状况将成为产品价格波动主要因素，运用新技术的产品由于掌握新技术新工艺的厂商较少，产品销售价格将保持较高水平；随着技术成熟度不断提升，产品销售价格将呈现波动下降的趋势。

公司面对半导体行业产品价格变动特点，虽然已逐步通过扩大优势产品产能，不断优化产品结构、开展技术创新、开发各类契合市场需求的新产品等多种方式予以应对，确保公司能够保持长期合理的利润水平。但若公司未来不能持续采取有效措施，降低产品成本、开发高端产品、积极参与市场竞争，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，将导致整体利润水平降低。

（七）实际控制人控制权稳定性风险

公司股权结构较为分散，共同实际控制人王成名、陈湛伦、张顺分别持股 21.11%、13.14%、10.07%，上述三人于 2014 年 2 月 20 日签署了《一致行动协议》，并于上述协议到期后 2019 年 2 月 21 日签署了新的《一致行动协议》，约定三人均在公司每次董事会、股东大会表决中保持一致意见，如各方经充分协商未能形成一致意见，以王成名的意见作为一致意见进行表决，一致行动的期限为协议生效之日起五年。期间如公司完成首次公开发行股票并上市，在协议约定的一致行动关系期限在公司发行上市后的 36 个月内届满的情形下，则协议约定的一致行动期限自动延长至自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月止。本次发行前，上述三人合计可支配股份表决权的比例为 44.32%，本次股票发行后，上述三人合计可支配股份表决权的比例为 33.24%，持股比例较低。

虽然实际控制人对于一致行动协议期满后已作出续签承诺，但如果《一致行动协议》在履行过程中出现无法正常履行或到期后出现未能继续保持一致行动的不可抗力情形，或出现其他股东增持股份谋求公司控制权的情形，将可能导致公司股权进一步分散，进而导致公司实际控制人发生变更或出现无实际控制人的情

形，可能会影响公司现有控制权的稳定，从而对公司管理团队和生产经营的稳定性产生不利影响。

同时，公司实际控制人兼董事王成名、陈湛伦、张顺年龄偏大，自公司设立以来，公司实际控制人均能够实际参与公司治理和经营管理，并能够正常履行实际控制人义务，但不排除未来可能出现影响其履行公司决策权和控制权的不利情形，公司存在控制权稳定性风险，可能对公司经营产生不利影响。

第二节 申请上市股票的发行情况

一、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股 (A 股)		
每股面值	1.00 元		
发行股数	本次发行股份 5,000 万股, 占本次发行后公司总股本的 25%。本次发行均为新股, 不涉及股东公开发售股份。	占发行后总股本比例	25.00%
其中: 发行新股数量	5,000 万股	占发行后总股本比例	25.00%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	20,000 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍 (按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算, 每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	4.83 元/股 (按本公司 2022 年未经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算)	发行前每股收益	0.44 元/股 (按本公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍 (按照发行前每股净资产计算); 【】倍 (按照发行后每股净资产计算)		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售 (如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。发行人和保荐人 (主承销商) 将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者 (如有)、网下投资者和符合投资者适当性要求且在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者 (国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外)		
承销方式	主承销商余额包销		

募集资金总额	【】万元
募集资金净额	扣除新股发行费用后，募集资金净额【】万元
募集资金投资项目	半导体封装测试扩建项目
	研发中心建设项目
发行费用概算	<p>本次发行费用明细如下：</p> <p>（1）承销费及保荐费：保荐费为 245.28 万元，募集资金总额中 5.5 亿元（含）及以下的部分，按 10%收取承销费，超出 5.5 亿元的部分，按 12%收取承销费；</p> <p>（2）审计及验资费用：1,509.43 万元；</p> <p>（3）律师费用：509.43 万元；</p> <p>（4）用于本次发行的信息披露费用：501.89 万元；</p> <p>（5）发行手续费及其他费用：17.84 万元。</p> <p>注：除承销费外，以上各项费用均不包含增值税，如有尾数差异，系四舍五入导致，各项费用根据发行结果可能会有所调整。发行手续费中暂未包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，将结合最终发行情况计算并纳入发行手续费</p>
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	-
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	-
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登初步询价及推介公告日期	2023 年 7 月 19 日
初步询价日期	2023 年 7 月 24 日
刊登发行公告日期	2023 年 7 月 27 日
申购日期	2023 年 7 月 28 日
缴款日期	2023 年 8 月 1 日
股票上市日期	本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市

二、本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

金元证券指定张敏和卢丹琴为蓝箭电子首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定刘绿璐为项目协办人；指定刘啸波、袁玉华、常广思、李莉、林森、常子昂、陈航为项目组成员，基本情况如下：

名称	金元证券股份有限公司
住所	海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法定代表人	陆涛
保荐代表人	张敏、卢丹琴
项目协办人	刘绿璐
其他项目组成员	刘啸波、袁玉华、常广思、李莉、林森、常子昂、陈航
联系电话	0755-83025500
传真号码	0755-83025657

（一）保荐代表人

1、张敏保荐业务执业情况

张敏，男，保荐代表人，硕士研究生，现任金元证券股份有限公司投资银行总部董事总经理，具有 22 年的投行工作经验，2004 年 5 月注册为首批保荐代表人，作为签字保荐代表人完成了联发股份首次公开发行股票项目、松德股份首次公开发行股票项目、宝泰隆非公开发行股票项目。

2、卢丹琴保荐业务执业情况

卢丹琴，女，保荐代表人，硕士研究生，现任金元证券股份有限公司投资银行总部执行董事。2012 年 3 月起从事投行业务，具有中国注册会计师、高级会计师、法律职业等资格，曾负责及参与赫美集团非公开发行、内蒙古锦联铝材有限公司非公开发行公司债券、金元一华源热力供热收费收益权资产支持专项计划等项目。

（二）项目协办人

项目协办人刘绿璐保荐业务执业情况

刘绿璐，女，现任金元证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理，作为项目现场负责人负责了宝泰隆（601011）2017 年非公开发行股票项目及宝泰隆公司债项目。作为主要成员完成了赫美集团（002356）2016 年非公开发行股票项目的申报、审核和过会等工作，作为主要成员完成了盘锦水务集团有限公司 2016 年非公开发行 10 亿元公司债项目，作为现场负责人负责过多家公司的企业改制、上市辅导和财务核查工作。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员分别为：刘啸波、袁玉华、常广思、李莉、林森、常子昂、陈航。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。

三、保荐人与发行人关联关系的说明

经核查，金元证券作为本次发行保荐人不存在可能影响公正履行保荐职责的情形，具体如下：

1、保荐人或者其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或者其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或者其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有保荐人或者其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、保荐人的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或者其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或者其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

第三节 保荐机构承诺

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。保荐机构同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照相关规定采取的监管措施；

9、自愿接受深圳证券交易所的自律监管；

10、中国证监会规定的其他事项。

第四节 对本次证券发行上市的保荐结论

一、本次发行上市履行了法定的决策程序

（一）董事会决策程序

2021年8月26日，发行人召开了第四届董事会第三次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案>的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）股东大会决策程序

2021年9月11日，发行人召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案>的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》等相关议案。

综上，保荐机构认为发行人已就本次发行履行了《公司法》、《证券法》、中国证监会规定以及深圳证券交易所有关业务规则的决策程序，决策程序合法有效。

二、符合板块定位及国家产业政策的说明

（一）发行人符合创业板定位的情况

1、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发注册管理办法》”）第三条，《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（以下简称“《暂行规定》”）第二条要求

根据《首发注册管理办法》第三条，发行人申请首次公开发行股票并上市，应当符合相关板块定位。根据《暂行规定》第二条，创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。

保荐机构就发行人符合创业板定位的核查说明如下：

(1) 发行人坚持创新驱动发展，创新、创造、创意特征突出，积极加快科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合步伐

1) 发行人创新、创造、创意特征

发行人拥有丰富的半导体器件生产经验，目前具有完善的半导体封装测试生产线，已形成年产超百亿只半导体产品的生产规模，是华南地区重要的半导体封测企业。

发行人作为专业从事半导体封测领域的高新技术企业创新特征明显，能够积极面向半导体科技前沿，能够有效突破自身关键核心技术，积极开展科技创新，实现 SIP 系统级封装技术和第三代半导体材料封装技术研发与应用；发行人深耕半导体封测领域，在封装细分领域核心技术具有较强竞争力，封装工艺和产品拥有多项创造；发行人利用丰富的封测技术积累以及敏锐的洞察客户需求的服务能力，开发出具有创意性的锂电保护 IC 产品，已取得相关集成电路布图设计专有权。

发行人目前已实际或计划积极开展新型功率器件、车规级器件以及应用于 5G 通讯基站、物联网、大数据产业等新产品的研发和埋入式板级封装、芯片级封装等先进技术的研发，为我国半导体产业发展贡献自身持续不断的创意，肩负起实现半导体国产替代的重任。

2) 发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况

半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。封装测试是半导体生产过程的重要环节，其技术水平直接决定了半导体器件的性能和使用寿命等关键因素。

发行人科技创新紧紧围绕半导体封测市场技术发展趋势，不断创新封测技术，已掌握多项封测领域关键技术，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在系统级封装、金属基板封装、超薄芯片封装、全集成的锂电保护 IC 等多方面拥有核心技术，持续向市场提供短小轻薄的分立器件和集成电路产品。

发行人通过引入应用机器人封装技术、AI 智能管理、制造业大数据分析系统等，目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，实现了供、产、销、研有机互联，能够从订单接收到产品出库实现全流程质量控制和实时监测，实现全流程的智能互联。

发行人构建了完备的研发体系。发行人核心技术人员均具备雄厚的专业能力和丰富的实践经验，目前已经形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。发行人重视和科研院校等机构的合作研发，已经与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作，部分主要合作成果已形成专利，并转化为发行人产品和技术。

因此，发行人符合创业板“三创四新”要求。

(2) 发行人具有较强的市场竞争力，报告期内业绩保持稳定增长，所处行业市场前景广阔，具有成长性

发行人市场竞争力较强。目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合。发行人已形成年产超百亿只半导体的生产规模，分立器件生产能力全国企业排名第八，位列内资企业第四，是华南地区重要的半导体封测企业。

发行人业绩稳定增长。受益于半导体行业需求的快速增长和发行人多年来研发成果持续在生产经营中的应用，发行人生产效率、经营规模不断提升，竞争优势不断增强，盈利能力持续增长。报告期内，发行人整体业绩稳定增长，报告期内，发行人的营业收入分别为 57,136.49 万元、73,587.41 万元和 75,163.36 万元，年复合增长率为 14.70%；扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为 4,324.51 万元、7,209.04 万元和 6,540.05 万元，年复合增长率为 22.98%。

发行人下游领域市场前景广阔。发行人产品广泛应用于智能家电、消费类电子、新能源汽车、工业控制、电源等多个领域。未来随着互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能、5G 等高新技术产业和战略性新兴产业的进一步发展，发行人下游应用市场将迎来较大的增量空间。

因此，发行人具备较强的市场竞争力，业绩保持稳定增长，下游市场广阔，具备成长性。

2、发行人符合《暂行规定》第三条要求

根据《暂行规定》第三条要求，深圳证券交易所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申报在创业板发行上市：

“（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年研发投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；

（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%；

（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%。

最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”

发行人符合《暂行规定》第三条相关指标要求的具体情况如下：

指标类别	指标要求	是否符合	指标情况	符合指标结果
创业板定位相关指标二	最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	发行人最近三年（2020 年至 2022 年）累计研发投入 10,351.81 万元	符合创业板定位相关指标二
	且最近三年营业收入复合增长率不低于 20%	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	发行人最近一年营业收入 7.52 亿元，超过 3 亿元，不适用最近三年营业收入复合增长率要求	
创业板定位相关指标三	属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用	发行人主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。发行人的相关产品及业务均属于战略性新兴产业分类中的新一代信息技术产业，属于制造业优化升级，属于现代产业体系领域	符合创业板定位相关指标三
	且最近三年营业收入复合增长率	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	发行人最近一年营业收入 7.52 亿元，超过 3 亿	

指标类别	指标要求	是否符合	指标情况	符合指标结果
	不低于 30%		元，不适用最近三年营业收入复合增长率要求	

发行人最近三年累计研发费用 10,351.81 万元，最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元；最近一年营业收入 7.52 亿元，超过 3 亿元，不适用最近三年营业收入复合增长率要求。因此，发行人符合《暂行规定》第三条标准二要求。

发行人主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。发行人的相关产品及业务均属于战略性新兴产业分类中的新一代信息技术产业，属于制造业优化升级，属于现代产业体系领域。发行人最近一年营业收入 7.52 亿元，超过 3 亿元，不适用最近三年营业收入复合增长率要求。因此，发行人符合《暂行规定》第三条标准三要求。

结合上述情况，发行人符合《暂行规定》第三条要求。

3、发行人符合《暂行规定》第五条要求

根据《暂行规定》第五条规定：“属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。”

发行人主营业务为半导体封装测试业务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），发行人属于计算机、通信和其他电子设备制造业下的电子器件制造业（行业代码：C397）。发行人不属于原则上不支持及禁止在创业板申报发行上市的行业。

因此，发行人符合《暂行规定》第五条要求。

综上所述，发行人符合《首发注册管理办法》、《暂行规定》关于创业板定

位的要求。

(二) 发行人符合国家产业政策的情况

公司主营业务为半导体封装测试业务。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业下的电子器件制造业（行业代码：C397）。

公司分立器件产品属于《国家重点支持的高新技术领域》分类中“一、电子信息”之“（六）新型电子元器件”之“3.大功率半导体器件”，属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）战略性新兴产业分类中“1.新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司集成电路封测属于《国家重点支持的高新技术领域》分类中“一、电子信息”之“（二）微电子技术”之“3.集成电路封装技术”，属于战略性新兴产业分类中“新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。

(三) 保荐机构执行的核查程序

1、查阅行业相关资料，对发行人管理层、核心技术人员进行访谈，获取行业相关信息、数据，对发行人的行业发展前景、市场地位、技术和竞争优势进行核查；

2、查阅发行人报告期内的财务报告和审计报告等财务相关资料，结合发行人实际业务情况进行财务分析，对发行人的成长性进行核查；

3、现场走访发行人生产经营场所，了解发行人生产设备、生产工艺及研发机构设置、研发流程等相关情况；

4、查阅发行人拥有的专利权证书等知识产权相关资料，并访谈发行人核心技术人员，了解相关技术对应的生产环节及具体作用，相关技术是否具有先进性；

5、查阅发行人所属行业相关报告及国家政策，了解发行人所属行业的市场容量、供求状况、发展趋势情况等。

6、查阅相关行业资料以及同行业可比上市公司的招股说明书、定期报告报

告等，了解行业内公司的技术水平特点；

7、查阅《暂行规定》，核实发行人业务所处行业是否属于原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业；发行人业务指标是否满足《暂行规定》要求。

经核查，保荐机构认为：发行人符合创业板定位要求，发行人业务和主要产品符合国家产业政策。

三、符合创业板上市条件的说明

保荐机构依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《创业板上市规则》”）相关规定，对发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

（一）本次发行符合证监会规定的创业板发行条件

保荐机构依据《证券法》和《首发注册管理办法》的相关规定，对发行人是否符合发行条件进行了逐项核查，核查意见如下：

1、本次发行符合《证券法》规定的发行条件

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构

经核查，发行人已根据《公司法》等法律、法规和规范性文件等相关规定的要求，并结合业务经营具体情况，建立、完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构并制定和完善了相关制度，设置了审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、战略委员会等董事会专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司股东大会、董事会、监事会按照《公司法》及公司章程的要求履行各自的权利和义务，重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照公司章程规定的程序与规则有效运作。

综上所述，发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

（2）发行人具有持续经营能力

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字[2023]

21000840470 号)及发行人的相关财务资料等,经保荐机构核查,发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度连续盈利,财务状况良好,具有持续经营能力,符合《证券法》第十二条第(二)项的规定。

(3) 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(华兴审字[2023]21000840470 号),发行人会计师认为,发行人经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的经营成果和现金流量。

综上所述,发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告,符合《证券法》第十二条第(三)项的规定。

(4) 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

保荐机构经对发行人相关人员进行访谈,取得并核查发行人控股股东、实际控制人的调查表,查询国家企业信用信息公示系统、信用中国、裁判文书网、中国执行信息公开网等网站,确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,符合《证券法》第十二条第(四)项的规定。

2、本次发行符合《首发注册管理办法》规定的发行条件

(1) 符合《首发注册管理办法》第十条的规定

保荐机构核查了发行人的公司章程、发行人工商档案、验资报告、营业执照等有关资料,确认发行人根据《公司法》在中国境内于 1998 年 12 月 30 日成立有限责任公司,2012 年 5 月 26 日,蓝箭有限召开股东会并作出决议,同意以公司截至 2011 年 12 月 31 日经审计净资产值 416,208,229.22 元折合股份 15,000 万股,整体变更为佛山市蓝箭电子股份有限公司,注册资本为 15,000 万元,余额 266,208,229.22 元全部作为资本公积金。2012 年 6 月 29 日,公司办理了工商变更登记,并领取了佛山市工商行政管理局颁发的注册号为 440600000023834 的《企业法人营业执照》。发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、资

产评估、验资、工商注册及变更登记等手续。发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

保荐机构查阅了发行人的章程、历次董事会、监事会、股东大会（股东会）决议、会议记录及相关制度文件，确认发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会制度，发行人的相关机构和人员能够依法履行职责。

综上所述，发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首发注册管理办法》第十条的规定。

（2）符合《首发注册管理办法》第十一条的规定

1）保荐机构取得了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的标准无保留意见的《审计报告》（华兴审字[2023] 21000840470号），并核查了发行人的相关财务管理制度、原始财务报表等资料。经核查，保荐机构认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《首发注册管理办法》第十一条第一款的规定。

2）保荐机构取得了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人出具的无保留结论的《内部控制鉴证报告》（华兴专字[2023] 21000840511号），并核查了发行人的内部控制相关执行凭证及文件资料。经核查，保荐机构认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，符合《首发注册管理办法》第十一条第二款的规定。

综上所述，发行人符合《首发注册管理办法》第十一条的规定。

（3）符合《首发注册管理办法》第十二条的规定

1）保荐机构获取并核查了发行人主要资产权属证明文件、员工劳动合同样本、关联交易相关合同及订单等资料。经核查，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

2) 保荐机构获取并核查了发行人工商档案资料、主要业务合同、关键人员劳动合同等资料。经核查,发行人主营业务、控制权和管理团队稳定,最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;发行人的股份权属清晰,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷,最近二年实际控制人没有发生变更,符合《首发注册管理办法》第十二条第(二)项的规定。

3) 保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等权属文件,查阅发行人借款和担保合同、诉讼及仲裁文件、信用报告,核查了网络信息,走访了主管机关并获取相应证明文件,访谈了发行人高级管理人员,确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保,不存在对发行人的生产、经营有重大影响的诉讼、仲裁等或有事项,不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项,符合《首发注册管理办法》第十二条第(三)项的规定。

综上所述,发行人符合《首发注册管理办法》第十二条的规定。

(4) 符合《首发注册管理办法》第十三条的规定

1) 保荐机构查阅了发行人所属行业相关法律法规和国家产业政策、生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等,访谈了发行人高级管理人员,实地查看了发行人生产经营场所,确认发行人生产经营活动符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策,符合《首发注册管理办法》第十三条第一款的规定;

2) 保荐机构对发行人主要股东及实际控制人进行了访谈,取得了相关说明与承诺,进行了相关公开信息查询,并取得了发行人工商、税收、海关等方面的主管机构出具的有关证明文件。经核查,报告期内,发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为,符合《首发注册管理办法》第十三条第二款的规定;

3) 保荐机构对发行人董事、监事和高级管理人员进行了访谈,取得了相关说明与承诺,进行了相关公开信息查询。经核查,发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《首发注册管理办法》第十三条第三款的规定。

综合上述，发行人符合《首发注册管理办法》第十三条的规定。

（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元

发行人目前的股本总额为人民币 15,000 万元。本次发行后，发行人的股本总额将达到人民币 20,000 万元，不低于人民币 3,000 万元，符合《创业板上市规则》对股本总额的要求。

（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上

发行人本次拟公开发行的股份数量为 5,000 万股，占本次发行后公司总股本的 25%，符合《创业板上市规则》对公开发行股份的比例要求。

（四）市值及财务指标

根据《创业板上市规则》第 2.1.2 条，发行人为境内企业且不存在表决权差异安排，市值及财务指标符合第一款的标准，即最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。

2021 年和 2022 年发行人经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为 7,209.04 万元、6,540.05 万元，最近 2 年累计归属于公司所有者的净利润 13,749.09 万元，符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元的财务指标。

四、对发行人持续督导期间的工作安排

事项	安排
（一）持续督导事项	金元证券将根据与发行人签订的保荐协议，针对发行人的具体情况，制定持续督导计划和实施方案，在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内履行持续督导义务，督导发行人履行有关创业板上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交其他文件。
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行；与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董监高利用职	根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助公司制定有关制度并督导其实施。

事项	安排
务之便损害发行人利益的内控制度	
3、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。
4、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽量避免和减少关联交易，若有关关联交易为发行人日常经营所必须或无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定执行，当关联交易达到一定金额需经独立董事发表意见并经董事会或股东大会批准；按照公平、独立的原则对重大的关联交易发表意见。
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人严格遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定，规范发行人担保行为的决策程序。
6、持续关注公共传媒关于发行人的报道	定期对发行人进行公开信息查询并进行记录；针对发行人发生的重大事项，关注公共传媒的报道情况，并及时与发行人沟通。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	持续关注发行人同行业与上下游的政策与经营环境变动情况，定期对发行人的公开信息进行查询；与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查。
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	按照保荐制度有关规定积极行使保荐职责，严格履行保荐协议、建立通畅的沟通联系渠道，要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议的约定，在持续督导期间向保荐机构履行持续督导责任提供一切条件；在持续督导期间内，保荐人对发行人的相关事项进行持续关注，并按有关规定发表独立意见，当出现违规情形时，督促发行人做出说明并限期改正，情节严重的，向深圳证券交易所报告；按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。

五、保荐结论

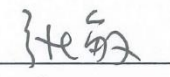

保荐机构根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首发注册管理办法》、《创业板上市规则》、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查、审慎的核查，对发行人申请首次公开发行股票并在创业板上市的可行性、未来发展前景、存在的风险因素及影响等方面进行了深入分析，并经内核会议进行了集体评审，认为蓝箭电子本次首次公开发行股票并在创业板上市履行了法律规定的决策程序，符合上述法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于首次公开发行股票并在创业板上市的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求。因此，保荐机构同意推荐蓝箭电子首次公开发行股票并在创业板上市，并承担保荐机构的相应责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

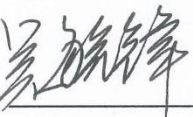
项目协办人：

刘绿璐

保荐代表人：
 
张敏 卢丹琴

内核负责人：

谢协彦

保荐业务负责人：

吴毓锋

法定代表人：

陆涛



金元证券股份有限公司

2023年7月19日